Hardware Block Diagram -3.3V-3.3V 3.3V Subsystem A-10 Voltage Detecting Module 电压侦测模块 Subsystem A-05 Subsystem A-06 Mode Selection Module Flash Module 存储模块 模式选择模块 3.3V -QSPI D3-SOP0 & TDO -QSPI D2--QSPI D1-SOP1 Subsystem A-02 -QSPI D0--QSPI_CS-Power Distribution Module SOP2 GND_{Power} -QSPI CLK-电源分配模块 Subsystem A-07 -3.3V-Crystal Module QSPI **←** 1.8V-晶振模块 **←** 1.2V-Power_+_12V= **←**1.0V-TDO_ -SDA--TDI-**JTAG** I^2C SCL -TCK--TMS-Subsystem A-04 Input SPI CLK-Module(Reserved) SPI CS-**IGN** SPI 信号输入模块 (预留) _MOSI-_MISO_ -UART TX-**UART** _UART RX_ Subsystem A-09 HMI Module (Reserved, 5V) нмі **←LVDS TXP 0**-输出模块(预留,5V) LVDS TXM 0− LVDS_TXP_1_ -INH-Local Wakeup LVDS_TXM_1_ **LVDS** Subsystem A-11 LVDS CLKP-Peripheral Module CAN L _LVDS_CLKM_ -3.3V-) 外围模块 LVDS_FRCLKP. -Tx--LVDS FRCLKM. Subsystem A-03 -RX-**CANFD Communication Module** -DMM DP0-→ CAN H -nSTB-CANFD通讯模块 _DMM_DP1_ _DMM_DP2_ -EN-_DMM_DP3_ **←**nFAULT -DMM DP4-→ ► DMM(HIL) _DMM_DP5_ _DMM_DP6_ _DMM DP7_ _DMM_CLK_ __DMM_SYNC_ Subsystem A-01 MCU Module + Antenna Module 微控制器模块+天线模块